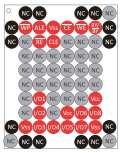
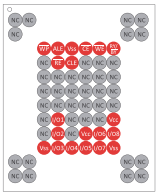
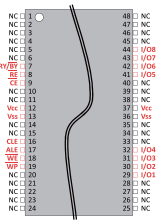
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

SLC NAND / BENAND™

封装技术信息

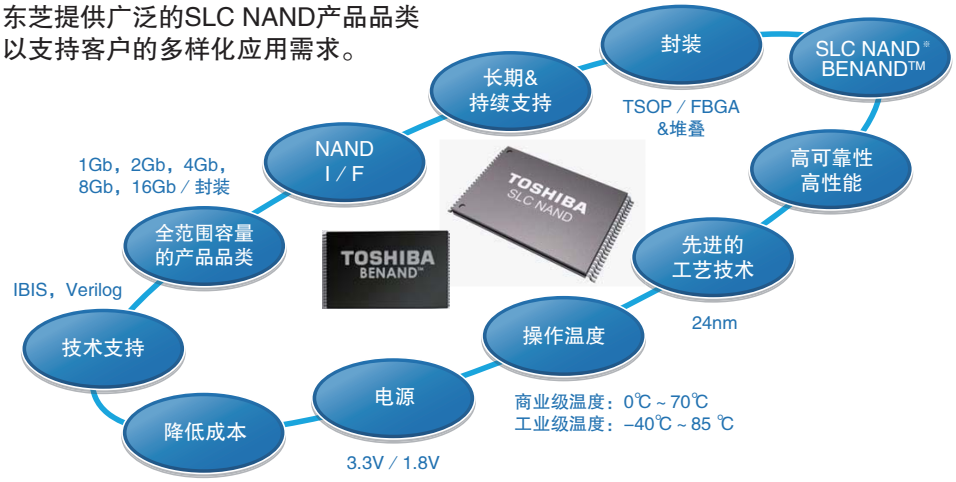
类型		67BGA	63BGA	48TSOP1
尺寸：		6.5mm × 8mm	9mm × 11mm	12mm × 20mm
球 / 引脚，间距		67球，0.8mm	63球，0.8mm	48球，0.5mm
Vcc		3.3V / 1.8V	3.3V / 1.8V	3.3V
样品				
球 / 引脚位置（顶视图）				
工艺 / 容量	24nm	1Gb / 2Gb / 4Gb / 4Gb × 2st	1Gb / 2Gb / 4Gb / 4Gb × 2st	1Gb / 2Gb / 4Gb / 4Gb × 2st / 4Gb × 4st

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

SLC NAND / BENAND™

特点

东芝提供广泛的SLC NAND产品品类
以支持客户的多样化应用需求。



现有的NOR闪存系统用户通过采用
SLC NAND将会获得更大的成本效益。

※BENAND（内置ECC NAND）是指具有内置硬件ECC的SLC NAND产品。
根据其主机ECC能力，客户可以使用适合的器件。